

光控華登基金完成「盛合晶微」半導體公司投資

2021年10月9日，光大控股（165.HK）宣佈旗下光控華登基金完成對領先的中段矽片製造和三維多芯片集成加工企業盛合晶微半導體有限公司（SJ Semiconductor Co.）的C輪投資，共同參與增資的投資人包括建信股權、建信信託、國方資本、碧桂園創投、華泰國際、金浦國調等，既有投資人元禾厚望、中金資本、元禾璞華也參與了本次增資。增資完成後，公司投後估值超過10億美元。盛合晶微是光大控股在先進半導體領域佈局的又一關鍵核心節點企業。



先進半導體是光大控股重點佈局的產業方向之一。在此方向上，光大控股先後佈局了光控精技（03302.HK）和上海微電子等“先進半導體裝備製造”企業，同時通過光控華登基金佈局了ASR、Indie等“先進半導體設計”企業。本次通過投資盛合晶微實現了在“先進半導體封裝”領域的佈局，進一步完善了光大控股在半導體領域的產業鏈佈局。

光控華登基金表示，“先進半導體是基金積極踐行光大控股新科技投資戰略的重要佈局領域，以投資助力中國半導體產業升級發展。盛合晶微作為我國芯片先進封裝領域的龍頭企業，公司產品和服務將為我國智慧視覺、智慧物聯網、智慧媒體、智慧出行、顯示交互、手機終端和數據中心等多個領域提供核心支撐”。



盛合晶微原名中芯長電半導體有限公司，是中國大陸第一家致力於 12 英寸中段凸塊和矽片級先進封裝的企業，也是大陸最早宣佈以 3DIC 多晶片集成封裝為發展方向的企業。公司在 2016 年即開始提供與 28 納米及 14 納米智慧手機 AP 晶片配套的高密度凸塊加工和測試服務，是大陸第一家提供高端 DRAM 晶片和 12 英寸電源管理晶片凸塊加工服務的企業。公司開發的 SmartPoser™ 三維多晶片集成加工技術平臺，在 5G 毫米波天線封裝領域展現了性能和製造方面的優勢，正在為越來越多的新興應用領域所認可。

目前，盛合晶微在先進封裝行業的技術研發實力、業務拓展能力、行業競爭地位和盈利能力等方面均處於行業領先地位。“先進封裝”行業市場前景廣闊，2019 年全球先進封裝市場規模 290 億美元，預計 2025 年增長到 420 億美元。中國先進封裝市場增長更為顯著，預計年均複合增速顯著高於全球增速。

此次光大控股對盛合晶微的 C 輪投資由旗下光控華登基金執行，光控華登基金是光大控股科技投資基金部和全球領先的半導體投資機構華登國際共同組建的合作平臺。目前光控華登已發起設立一期、二期美元基金和包括盛合晶微在內的兩支專項基金，重點關注中國和全球先進半導體領域的股權投資，目前已有專案陸續退出，獲得了豐厚的投資回報。